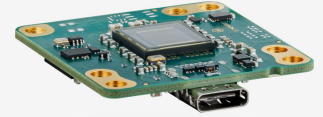
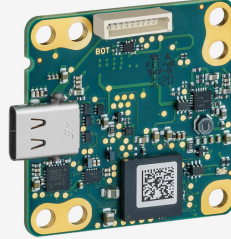
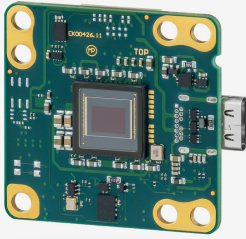


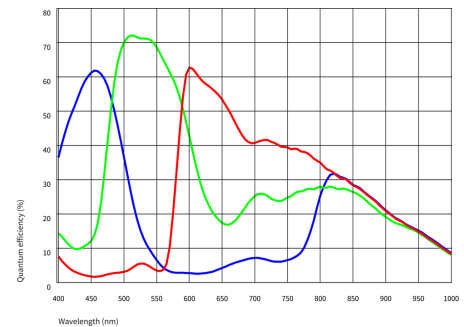
■ 新規の採用は非推奨
このカメラモデルは新規の採用には非推奨です。



仕様

センサー

センサーのタイプ	CMOS カラー
シャッター	ローリングシャッター
特性	リニア
解像度/ピクセル	8 MP
有効画素数	8.41 メガピクセル
有効画素数 (h x v)	3864 x 2176 ピクセル
アスペクト比	16:9
ADC	12 bit
色深度 (カメラ)	12 bit
光学センサークラス	1/2.8"
撮像面積	5.603 mm x 3.155 mm
光学センサーの対角	6.43 mm 1/2.8"
画素サイズ	1.45 μm
CRA (主光線角)	0 °
メーカー	Sony
センサーモデル	IMX415-AAQR-C
ゲイン (マスター/RGB)	27.5x/-
AOI 水平	同じフレームレート
AOI 垂直	増加したフレームレート
AOI 画像の幅、ステップ幅	24 / 24
AOI 画像の高さ、ステップ幅	40 / 8
AOI 位置グリッド (水平/垂直)	2 / 2
ビニング水平	増加したフレームレート
ビニング垂直	増加したフレームレート
ビニング手法	水平: 平均 / 垂直: 平均
ビニング係数	2x2
デシメーション(サブサンプリング) 水平	-
デシメーション(サブサンプリング) 垂直	-
デシメーション(サブサンプリング) 手法	-



技術は変更されることがあります (2026-09-12)

ページ 1 の 3

www.ids-imaging.jp

IDS Imaging Development Systems GmbH

Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · E メール apacsales@ids-imaging.com

モデル

フレームレートフリーランモード	25 fps @ 10Bit
フレームレートトリガー（連続）	25 fps @ 10Bit
フレームレートトリガー（最大）	25 fps @ 10Bit
露出時間（最小～最大）	0.019 ms - 1999 ms
消費電力	0.5 W - 1 W
画像メモリ	-

環境条件

PCB バージョンについては、該当するドキュメントのヒントを参照してください。

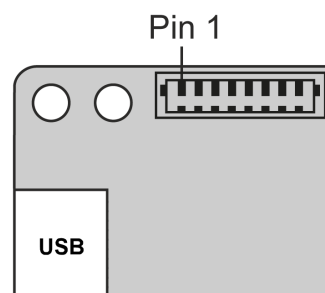
動作時の許容デバイス温度	0 ° C - 75 ° C / 32 ° F - 167 ° F
保管時の許容デバイス温度	-20 ° C - 80 ° C / -4 ° F - 176 ° F
湿度（相対湿度、結露なし）	20 % - 80 %

コネクタ

インターフェースコネクタ	USB Type-C
I/O コネクタ	Wuerth 製 8 ピンコネクタ
電源	USB ケーブル

ピン割り当て I/O コネクタ

1	電圧出力 3.3 V
2	接地 (GND)
3	オプトカプラなしのフラッシュ出力 - Line 1
4	オプトカプラなしのトリガー入力 - Line 0
5	汎用入出力 (GPIO) 1 - Line 2
6	汎用入出力 (GPIO) 2 - Line 3
7	接地 (GND)
8	USB 給電: 5 V、最大 400 mA



設計

レンズマウント	No mount
保護構造	-
外形寸法	36.0 mm x 36.0 mm x 8.0 mm
重量	7 g
ハウジング素材	-

Features

オンカメラ画像前処理機能のリスト。

このテーブルのすべての機能は、ホストコンピュータ上で画像の前処理を行うための IDS peak ソフトウェアを介して利用可能です（センサーのモデルによって異なります）。

画像取得	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	✓
	Trigger controlled exposure	-
	Denoiser	-
	Long exposure	-
	Line scan	-
	Global start	-
フラッシュ	Flashing	-
	PWM flashing	-

U3-38J2XLE-C Rev. 1.2 (1008775)

画像調整

Auto exposure	-
Auto gain	-
Auto whitebalance	-
Color correction	-
Gamma	-
LUT	-
Mirror/flip	X/Y

統合画像処理

Pixel formats	BayerRG10g40IDS BayerRG12g24IDS
Region of interest	✓
Decimation (FPGA)	-
Decimation (Sensor)	
Binning (FPGA)	-
Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.

その他

Chunks	-
Sequencer	-
Events	-
Firmware update	✓
1st supported firmware version	3.2